

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	48 家机构（共 52 人）参与公司于 2026 年 7 月 16 日-2026 年 7 月 17 日举行的投资者交流会，其中包括： 富国基金、嘉实基金、信达澳亚基金、易方达基金、广发基金、博时基金、安信基金、建信基金、新华基金、华安基金、南方基金、银河基金、鹏华基金、富安达基金、申万菱信基金、融通基金、光大保德信基金、国联基金、大湾区发展基金、江苏瑞华基金、五矿资本、阳光资产、创金合信基金、圆信永丰基金、天风证券、华泰证券、国泰君安资产管理、广东正圆投资、湖南长心私募基金、北京信弘天禾投资、北京鸿道投资、玄卜投资、浙江益恒投资、深圳宏鼎财富、闻天私募、承珞（上海）投资、深圳宽源私募、龙赢富泽资产、上海大箏资产、新疆前海联合基金、深圳市康曼德资本、深圳瑞信致远私募、深圳市前海登程资产、旌安投资、上海明沢投资、浩成资产、姚径河投资、Pinpoint Asset Management Limited
时间	2026 年 7 月 16 日 15:00-16:00

	2026 年 7 月 17 日 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：邱鹏 董事、总经理：关巍 董事会秘书兼财务负责人：廖新江 证券事务代表兼法务负责人：苏晓倩
投资者关系活动主要内容介绍	首先，邱鹏先生对公司情况进行了简要介绍，然后开始投资者交流环节。交流环节主要涉及的问题及回复如下： 1. 请简要介绍公司 AI 相关业务营收情况、营收占比及近年增速，并对光芯片、光模块、半导体、液冷等相关板块营收进行拆分说明。 回复：公司主营业务为电子产品自动化设备和半导体设备，近年来持续围绕消费电子、显示、光通信、IC 封测等领域拓展。AI 算力基础设施建设带动高速光芯片、光模块、光器件、半导体先进封装以及液冷服务器等环节向公司设备需求提升。 从业务方向看，公司受益于 AI 产业发展的产品主要包括：一是光芯片领域的排巴、拆巴、AOI 检测、芯片摆盘及贴片等设备；二是高速光模块自动化生产线及相关单机设备；三是半导体固晶、倒装键合及封装自动化设备；四是液冷服务器部件组装测试环节的自动化设备机会。 目前，公司尚未按照“光芯片、光模块、半导体、光模块自动化线”等口径单独拆分披露收入、占比及增速。2025 年度公司半导体板块的业务实现营业收入 10,492.48 万元，占公司营业收入的 17.30%，2025 年半导体业务收入同比增长 48.96%，正加速成为核心增长引擎。 2. 请讲解公司光芯片核心产品排巴机、拆巴机、AOI 三

	款设备的产品布局、技术优势以及核心技术壁垒。 回复：公司在光通信半导体领域围绕光芯片制造及封装工艺形成了较完整的设备布局。排巴机主要用于巴条的高精度排列和自动化流转；拆巴机主要用于巴条拆分及后续芯片处理；AOI 设备主要用于芯片外观、位置及缺陷的自动识别和检测。三类设备可覆盖光芯片生产中的多个关键环节，并可根据客户工艺进行组合配置和产线协同。 相关产品的技术壁垒主要体现在四个方面：一是高精度运动控制，要求设备在微小尺寸、高节拍条件下保持稳定定位和重复精度；二是视觉检测及算法能力，需要对微小缺陷、位置偏差和产品一致性进行准确识别；三是微小芯片及巴条的稳定搬运与姿态控制，需要兼顾效率、低损伤率和良率；四是客户工艺适配与量产交付能力，设备通常需要结合不同客户的产品形态、工艺路线和节拍要求持续迭代。 3. 请介绍公司与东山精密及其全资子公司索尔思光电的产品导入进度，并分析该客户整体需求前景以及下游订单传导至公司带来的业务增量空间。 回复：从产业链传导逻辑看，AI 算力需求增长推动高速光模块升级和扩产，进一步带动上游光芯片、光器件以及相应生产设备需求。光芯片产能扩张和工艺升级通常会传导至排巴、拆巴、AOI 检测、芯片摆盘、贴片及自动化流转等设备环节。公司已经围绕上述关键工艺形成产品布局，具备承接客户扩产和自动化升级需求的基础。 光芯片企业扩产通常需要提前进行设备选型、验证和产线建设，因此设备需求具有一定前置性。随着下游客户对 2027 年至 2028 年需求规划逐步明确，行业远期可见度提升，有利于推动上游厂商提前安排产能和设备投入。 对于单一客户带来的增量空间，应结合客户资本开支、设
--	---

	备验证、订单释放、交付验收及收入确认节奏综合判断。 4. 请介绍公司在源杰科技、长光华芯、光迅科技等其他主流光芯片客户的设备导入与量产落地进展。 回复：公司持续关注国内外主流光芯片、光器件及光模块企业的设备需求，并围绕排巴、拆巴、AOI 开展客户验证和市场拓展。 随着国内光芯片企业扩产和高功率 CW 光源、 EML 等产品升级，相关设备需求有望同步提升。总体而言，公司会依托既有产品平台和工艺能力，持续扩大主流客户覆盖，提升产品复用率和项目交付效率。 5. 请介绍公司光模块自动化线在核心客户处的导入情况与项目落地进展。 回复：公司在光模块自动化设备领域，围绕高速光模块制造及封装自动化需求，持续推进整线及关键单机设备的研发和市场拓展。相关产品可应用于光模块生产过程中的自动装配、检测、贴装、搬运、流转及产线集成等环节，有助于客户提升生产效率、工艺一致性和量产稳定性。 随着光模块向 800G、1.6T 及更高速率演进，产品结构和封装工艺更加复杂，客户对自动化率、良率控制、柔性生产和整线协同能力提出更高要求。公司目前正结合客户需求推进相关项目验证和交付。 6. Micro LED 作为光模块领域的新型光源方案，公司具备丰富的 LED 存量客户资源，请问公司如何看待该赛道带来的新机遇与未来业务增量空间？ 回复：公司长期关注 Mini LED、Micro LED 及其他微小芯片应用方向，并在芯片检测、分选、视觉识别、精密搬运和自动化生产等方面积累了相关技术和客户服务经验。这些底层能
--	--

力与光通信领域具有一定共通性。

Micro LED 作为光模块新型光源方案，未来将形成明确的产业化需求，公司可依托既有 Mini/Micro LED 客户资源、设备平台能力和工艺理解，积极关注相关设备机会，并根据客户需求推进产品开发和验证。

7. 请介绍公司半导体倒装键合设备的产品概况、技术优势及各类应用场景，重点说明在存储芯片领域的落地应用与客户进展。

回复：公司半导体设备重点布局中后道工艺环节，围绕芯片检测、分选、贴片、倒装键合及封装自动化等关键工艺开展研发和产品化。倒装键合设备主要用于芯片与基板或芯片之间的高精度对位、贴装和互连，可应用于先进封装、存储芯片、功率器件、CIS、光通信器件等场景。

该类设备的核心技术优势主要包括：高精度对位和重复定位能力；对压力、温度、运动轨迹等工艺参数的稳定控制；对不同芯片尺寸、基板材料及封装形式的兼容性；以及长期量产条件下的稳定性和良率保障能力。

在存储及先进封装领域，随着高密度集成、异质集成等技术发展，客户对高精度贴片和倒装键合设备的需求持续提升。公司正结合客户需求推进相关产品研发、验证和市场拓展。

8. 请介绍公司存储领域高端分选机的客户导入进度，以及核心客户的合作落地与量产情况。

回复：公司在半导体检测分选设备方面持续进行产品布局。高端分选机主要应用于芯片测试后的检测、分类、搬运、编带以及后续工序衔接，是半导体封测产线中的重要设备。

存储芯片、CIS 等高端应用对分选设备的高精度、高稳定性、高节拍、低损伤率、兼容性及长期量产可靠性提出较高要

求。公司将结合客户产品形态、测试要求和工艺路线持续推进设备研发、验证及量产导入。

9. 请介绍公司精密运动平台系统的业务布局、商业模式、行业未来前景，以及该核心零部件在半导体设备国产化进程中的重要价值。

回复：精密运动平台系统是半导体检测、量测、封装和高端封装设备的重要功能模块，直接影响整机的定位精度、重复精度、运行稳定性和生产效率。在晶圆检测、量测、混合键合等场景中，设备对纳米级、亚微米级运动控制能力要求较高，技术门槛主要体现在精密机械设计、运动控制、软件算法、误差补偿及长期稳定性等方面。公司参股的施耐博格精密系统（深圳）有限公司主要从事精密单轴、多轴运动系统的开发、生产和销售。

公司围绕高端装备核心能力建设，持续推进高精度运动控制、视觉检测、软件算法和系统集成等关键技术。相关业务可通过核心模块供应、联合开发、定制化解决方案和技术服务等方式，与整机设备厂形成协同效应。从国产化角度看，精密运动平台属于影响整机性能的重要底层能力，将推动相关核心模块国产化，有助于提高本土设备供应链的自主可控水平，并缩短整机企业的研发和交付周期。

10. 在当前存储、半导体行业持续扩产的大背景下，请详细梳理除上述产品外，公司还有哪些业务板块能够受益、具备明确增长逻辑？

回复：除光芯片分选、排巴/拆巴设备、光模块自动化线、倒装键合设备及精密运动平台外，公司还可从以下方向受益于半导体扩产和国产化进程：

一是功率半导体相关检测、分选、固晶及封装自动化设备；二是 CIS、MEMS 等传感器领域的检测、分选和封装设备；三

是 IC 板级封装领域的晶圆排片、检测、分选、编带、多芯片贴片及倒装贴片设备；四是面向不同工艺环节的半导体自动化产线和非标自动化解决方案。

这些业务的共同增长逻辑来自下游扩产、工艺升级、人工替代以及核心设备国产化。光芯片及半导体企业扩产通常需要提前进行关键物料锁定、设备采购和产线验证，因此设备需求具有一定前置性。但不同产品的客户验证周期、市场竞争和订单释放节奏存在差异，公司会根据技术成熟度和市场需求稳步推进。

11. 请介绍公司服务器液冷业务的相关产品布局、客户导入情况，并展望该板块未来的业务增量空间与成长确定性。

回复：AI 服务器和高性能算力基础设施快速发展，对散热效率、能耗控制及系统可靠性提出更高要求，推动液冷产业链加速发展。公司可结合既有检测、组装、流体控制、密封检测和自动化集成能力，关注液冷部件制造、测试、装配及自动化产线等设备需求。

公司会根据客户项目需求推进相关产品研发和市场拓展。液冷相关设备的机会主要来自数据中心建设、服务器功率密度提升及液冷渗透率的提高。

12. 公司近年来研发费用持续高增，请拆解研发费用的具体投入方向与落地场景，并分析当前研发投入节奏与公司中长期业务增长的匹配性。

回复：公司的研发投入主要围绕以下方向展开：一是 Mini LED、Micro LED 等显示和泛半导体设备；二是光通信半导体设备，包括光芯片排巴、拆巴、AOI 检测、摆盘、贴片；三是 IC 固晶及贴片半导体设备，包括倒装键合及封装自动化；四是高精度运动控制、视觉检测、软件算法和控制系统等平台型技

	术；五是自动化产线标准化、模块化和柔性化能力建设。 研发投入既包括新产品研发，也包括既有产品性能提升、客户工艺适配、样机验证和量产稳定性改进。短期看，研发投入会对费用端形成一定压力；中长期看，有助于公司提升产品技术壁垒、拓展应用场景、增强客户黏性，并支撑公司从传统消费电子自动化向光电及传统封装、先进封装领域延伸。 公司重视研发投入，2025 年公司研发投入 7,010.59 万元，同比增长 30.73%，研发投入占营业收入比例为 11.56%，支撑半导体设备收入占比持续提升。公司通过持续技术迭代和产品矩阵扩展，强化在高端装备国产化领域的核心竞争力。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 17 日